## <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭57—28689

f) Int. Cl.<sup>3</sup>B 23 K 20/00 20/14 識別記号

庁内整理番号 6554--4E 6554--4E **②公開** 昭和57年(1982)2月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

## ❷拡散接合方法

②特 顧 昭55-101134

②出 願 昭55(1980) 7月25日

@発明者河野顕臣

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内 **@発明者田口啓二** 

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内

の出願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

砂代 理 人 弁理士 薄田利幸

卓 組 44

- 1 発明の名称 拡散接合方法
- 2 特許請求の範囲

高真空中で級合部材を固相離以下の温度に加熱し、かつ加圧して接合させる拡散接合方法において、前記級合部材の周接合面を加圧密着させる以前に、その両接合面を互いに順離した状態で最合温度以上に加熱して所定時間保持し、両接合面をを清浄化した後に所定の接合温度まで降温させ、ついて緩合部材に圧力を付加して両接合面同志を密着させた後に、所定の接合圧力を付与して所定時間加熱することを特徴とする拡散を方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は高真空中で接合部材を固相線以下の最 度に加熱し、かつ加圧して接合する拡散接合方法 に関するものである。

従来のとの種或飲養合方法では、複合部材はその複合面間志を重ね合せた状態で原定無度まで加 熟されると共に、この無度で加圧されて保持され るので、前記接合面は高量でかつ高真空中にさら されない。金属が真空中で加熱されると、金属表面に付着していた水分かよび油脂分などは除去されるばかりでなく、真空度が高ければ高いほど表面酸化物は解離する。

ところが上記のように両接合面が最初から重合されていると、金属から放出されるアクトガスは前記接合面にこもるため、高真空かよび高温のもとにかける金属の清浄化作用が阻害される。特に拡散接合では接合面の清浄が非常に重要であるが、上述した従来の方法では接合節の機械的性質、特に衝撃特性が着しく低下する恐れがある。

本発明は上記欠点を除去することを目的とする もので、高其空中で接合部材の両接合面を加圧密 着させる以前に、その接合面を隔離した状態で短 時間、接合量度以上に加熱し、接合面に付着している酸化物かよびコンタミネーションを除去する と共に、金属内部から放出されるアウトガスを十 分に除去した後、接合面同志を重ね合せて所定の 接合量度で所定時間加圧保持するようにしたこと を得象とするものである。 BEST AVAILABLE COPY

The many of the section of the secti

以下本発明の一実施理様を図面を参照して説明する。

第1四は本発明を適用した拡散接合接置で、1,2はCr225%かよびMo1%を含有する網からなる接合部材、3,4は接合部材1,2をそれぞれ保持する上。下加圧治具、5,6は真空テヤンパ10の機を貫通する上。下加圧ラムで、との上。下加圧ラム5,6の真空テヤンパ10内に存在する先端には前記加圧治具3,4がそれぞれ取付けられている。7は下加圧ラム6を上下動させる加圧シリンダ、8は下加圧治具4の上面上に接合部材2を取倒むように取付けられたTi格製円の体、9は上。下加圧治具3,4の間に配設され、かつ前配簡体8を取囲むように設けられた円筒状と一タである。

次化上配のような構成からなる拡散接合装置の 作用について説明する。

まず真空チャンパ10内を真空排気して10<sup>-4</sup> torr以下の状態にした後、接合部材1,2をヒータ9により拡散接合温度より20で高い温度

一衝撃値は  $4\sim6~k_B~m/cm^2$ である。これに対し本発明を適用すれば、前配と同条件のもとでシャルビー衝撃値が  $8\sim1~0~k_B~m/cm^2$ まで向上することが確認された。

以上成明したように、本発明によれば従来のような脱脂処理などの接合面の前処理が不要となる ばかりでなく、接合部の機械的性質の向上をはか ることができる。

## 4. 凶面の簡単な説明

を できる できる

第1図は本発明の拡散接合方法を適用した拡散 接合装置の一実施例を示す断面図、第2図は同実 施例の拡散接合処理を示す級図である。

1.2…接合部材、3.4…加圧治具、5.6… 加圧ラム、9…ヒータ。

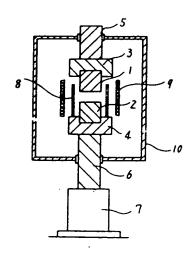
代理人 弁理士 存田利幸

1時間57-28689(2)
1020でまで加熱し、この温度1020でで
20分間加熱保持する。この加熱保持中、接合部材1。2の両接合面は互いに隔離され、かつ
1020でで10-4 torr以下の真空中にさらされているため、接合面のコンタミネーションをよびアミュロ。などの酸化皮膜を接合面より排除することができ、同時に接合面近傍の母材内の吸収ガスもその表面より放出される。

上記の清浄化シよびペーキングが終了した時点で、伊内の温度は拡散接合温度1000でまで降温され、下加圧ラム6を介して接合部材1,2の接合面を密着させる。そして前記接合面を所定の接合圧力3㎏/==²まで加圧すると共代1時間加熱保持する。その後に接合部材1,2は常温まで冷却されて拡散接合処理が完了する。とのような拡散接合処理を図示すると第2図のようになる。

すなわちC \* 2.2 5 % および M º 1 % を含む鎖からなる接合部材の拡散接合において、接合温度 1 0 0 0 ℃、接合圧力 3 kg/== \* および接合時間 1 時間などの条件のもとでは、接合部のシャルビ

第1回



第 2 月

